

2025JEITA-技戦第 318 号

2025 年 5 月 27 日

関係各位

一般社団法人電子情報技術産業協会
電子材料・デバイス技術専門委員会
事務局

「2025 年度先端電子材料・デバイス技術フォーラム」のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対し格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「先端電子材料・デバイス技術フォーラム」を下記要領にて開催することとなりました。電子材料・デバイス技術専門委員会傘下の一部分科会での 2023～2024 年度にわたる調査活動報告とともに、2024 年度 JEITA ベンチャー表彰 Early edge 賞(特別賞)を受賞された株式会社 JiMED 代表取締役 中村 仁様をお招きした講演も行います。是非ご出席頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 2025 年 7 月 22 日(火) 15:00～17:00

形 式 Web 開催 (Webex ウェビナーを予定)

プログラム

15:00～15:05	「開会挨拶」 電子材料・デバイス技術専門委員会
15:05～15:45	招待講演：「BCI 技術による社会課題解決及び今後の市場化に向けて」 講 師：中村 仁氏 株式会社 JiMED 代表取締役 ・第 10 回 (2025. 3/27) JEITA ベンチャー賞、審査評価以下参照 https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2025/venture.html ・JiMED 社ホームページ： https://www.jimed.jp/
15:45～16:15	「シーンオリエンテッド先端実装技術に関する技術動向」 大場 隆之氏 シーンオリエンテッド先端実装技術分科会委員長(～2024年度) (東京科学大学 総合研究院WOWアライアンス異種機能集積研究ユニット特任教授)
16:15～16:45	「サイバー空間と実空間の安全な融合を支えるデバイス・ハードウェアセキュリティ技術動向」 本間 尚文氏 デバイス・ハードウェアセキュリティ技術分科会委員長(～2024 年度) (東北大学 電気通信研究所 教授)
16:45～	閉 会

【主 催】 電子材料・デバイス技術専門委員会

【参加費】 無料

【申込方法】 ご参加希望の方は、下記の参加申込フォームに必要事項をご入力頂き 7/16(水) までにお申込み願います。

<参加申込フォーム> <https://www.jeita.or.jp/form/custom/273/form>

備 考：・報告会前日までにご登録いただいたメールアドレス宛にアクセス先をお知らせします。

- ・本報告会の録音、録画および投影資料の撮影等はご遠慮下さい。
- ・サインインしていただく際、ご所属とお名前をご入力ください(例：JEITA 電子太郎)。

事前にご登録頂いてない方はサインインができません。

- ・本講演会の内容につきましては、ご聴講いただいた各社内においてのみの共有にてお願いいたします

問合せ先：〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル 4 階

一般社団法人電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部（担当：鈴木）

E-mail：hisaki-suzuki@jeita.or.jp, TEL080-2392-1695

（※在宅勤務の都合上、メールでのお問合せをお願いいたします）

以 上